

「プロセス可視化・知能化技術分科会」会員募集

本年4月より4年間、新たに上記名称の分科会を発足させることになりました。会員から参加希望者を募ることになりましたので関心のある方の積極的参加を求めます。

- 1) 分科会名称 プロセス可視化・知能化技術分科会
- 2) 設置期間 2017年4月1日から4年間
- 3) 設置目的 サーボプレスの普及による塑性加工のデジタル化が進み、さらにインダストリー4.0などの次世代生産技術が求められる中、塑性加工プロセスの見える化、知能化に関する要素及びシステム技術の研究開発が益々重要となってきました。このような状況において、各種センサー技術（ハードセンシング）、プロセスシミュレーション技術（ソフトセンシング）、CAE技術（最適設計）、さらにこれらの技術をサーボプレスに適用したデジタル制御技術の調査・研究を目的とします。
- 4) 研究組織 主査 楊 明（首都大学東京） 幹事 高橋進（日本大学）、松本 良（大阪大学）
- 5) 会費 会費は以下のような額とし、委員会欠席者には資料を郵送する。

個人会員	4,000円
営利団体・賛助会員	8,000円
学生会員	1,000円
- 6) 事業 以下の内容に関連するセミナー（シンポジウムを含む）・見学会を年4回程度開催します。ほか、関連研究の調査、講演会でのテーマセッションの企画を行います。

- ① サーボプレスモーション利用技術及び各種現象の計測技術（ステップ加工、振り子モーション、パルスモーションなど）
- ② 各種モーションに関するプロセスシミュレーション技術
- ③ マイクロセンサー創製および利用技術（金型内蔵センサーなど）
- ④ プロセスシミュレーション（ソフトセンシング）と各種センサー情報（ハードセンシング）と融合したプロセス可視化技術
- ⑤ センシング技術とサーボプレス制御技術との融合によりモーションの最適化
- ⑥ IoT融合による情報管理技術・データプロセス技術

- 7) 第1回セミナー「ものづくり分野におけるIoT活用への取組み」および総会を以下の要領で開催します。

日 時：7月24日（水）13:30-16:30

会 場：(株)日立製作所 横浜研究所

〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 602A会議室

交 通：J最寄り駅はJR東海道線・横須賀線・湘南新宿ライン 戸塚駅より徒歩10分

アクセス：<http://www.hitachi.co.jp/rd/about/location/yrl/index.html>

8) 参加申し込み方法

下記メールアドレスに、企業名・所属・氏名・連絡先、第1回研セミナー参加、あるいは分科会入会希望の有無を記入して送信してください。折り返し詳細についてご案内します。

申込先：日本塑性加工学会 プロセス可視化・知能化技術分科会

首都大学東京 システムデザイン研究科 楊 明研究室内 藤沢 浩子 宛

E-mail: fujisawa@tmu.ac.jp

電話/FAX:042-585-8440